

## 技术参数

# 5612

日期 : 05/2018  
上海禧合应用材料



### 应用介绍

#### 特点

一款单组份、加热快速固化底填保护胶，可自流平，具有粘接强度高、耐高温高湿性能好，易返修等特点；适用于电子芯片底填及包封保护粘接

#### 粘接材料

玻璃，金属，陶瓷，油墨等

#### 典型应用

PCB 板芯片包封及底填保护

### 固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色	
粘度(cps)	1181	10rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	2mins@150°C 5mins@120°C	
有效期@ -5°C,月	6	

\*固化温度指的是胶水表面实际达到的温度

### 固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	78D	ASTM D-2240
玻璃化温度	35°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
降解温度	350°C	
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	ASTM D 570-98
工作温度范围*	-55°C—150°C	

### 储存和使用方法

低于-5°C冷冻保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少解冻 2 小时，大包装 55ml 以上解冻不少于 4 小时；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

#### 注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

[www.stick1mat.com](http://www.stick1mat.com)

Email: [info@stick1mat.com](mailto:info@stick1mat.com)

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

